
2024年12月期 第1四半期 決算説明会

2024年5月10日（金）

 **メック株式会社**

証券CODE:4971

<https://www.mec-co.com/>

2024年12月期 業績予想修正について



第2四半期 連結（累計）業績予想	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に 帰属する 当期純利益	1株当たり 当期純利益
前回発表予想（A）	百万円 7,850	百万円 1,300	百万円 1,350	百万円 950	円 銭 50.73
今回修正予想（B）	8,350	1,800	1,900	1,300	69.43
増減額（B - A）	500	500	550	350	
増減率（%）	6.4	38.5	40.7	36.8	
（ご参考）前期実績 （2023年12月期第2四半期）	6,198	838	1,003	1,076	56.79
通期 連結業績予想	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に 帰属する 当期純利益	1株当たり 当期純利益
前回発表予想（A）	百万円 16,300	百万円 3,000	百万円 3,100	百万円 2,150	円 銭 114.82
今回修正予想（B）	17,000	3,650	3,800	2,650	141.52
増減額（B - A）	700	650	700	500	
増減率（%）	4.3	21.7	22.6	23.3	
（ご参考）前期実績 （2023年12月期）	14,020	2,492	2,683	2,304	122.29

1 売上：4,354百万円（前年同期比 57.5%増）
営業利益：1,053百万円（前年同期比 523.7%増）

2 為替の影響は前年同期比
売上：176百万円増、営業利益：100百万円増

3 薬品売上：3,924百万円（前年同期比 44.7%増）
出荷量：9,850ton（前年同期比 31.4%増）

4 主要製品売上は前年同期比
CZ 58.0%増、EXE 37.0%増、SF 8.3%増、V-Bond 7.2%増

(単位：円)

	期初想定	2024Q1	2023Q1	2023Q4
N T D	4.48	4.71	4.37	4.52
R M B	19.66	20.55	19.33	19.81
H K D	17.73	18.90	17.02	17.96
T H B	4.01	4.16	3.90	4.04
E U R	150.22	160.89	143.34	152.27
U S D	138.87	147.86	133.26	140.55

2024/5/10公表業績修正における想定レートは2024Q1期中平均レートを使用

- 海外現地法人は、基本的に現地通貨建てでの取引であり、連結会計で円換算する際に、円／現地通貨レートの影響を受ける。
- いずれも、期中平均レートを採用。
- 当社の主要外国通貨は、台湾ドル（NTD）、中国人民元（RMB）。
- 各通貨に対して想定レートから0.1円変動する場合の影響額は次のとおり。

NTD：（売上）16百万円（営業利益）12百万円

RMB：（売上）6百万円（営業利益）3百万円 *いずれも、当期Q1実績

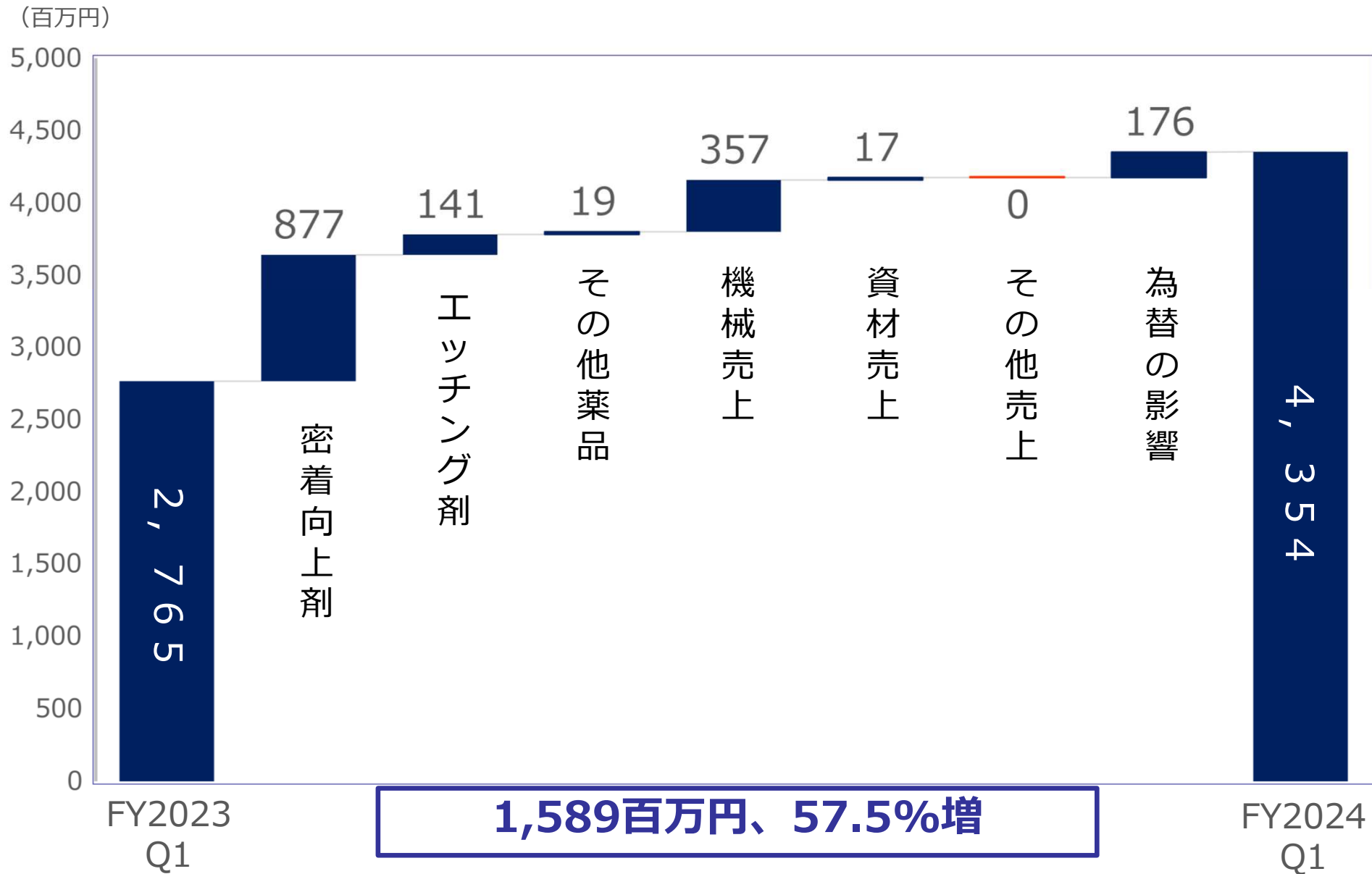
2024年12月期 第1四半期 業績概要



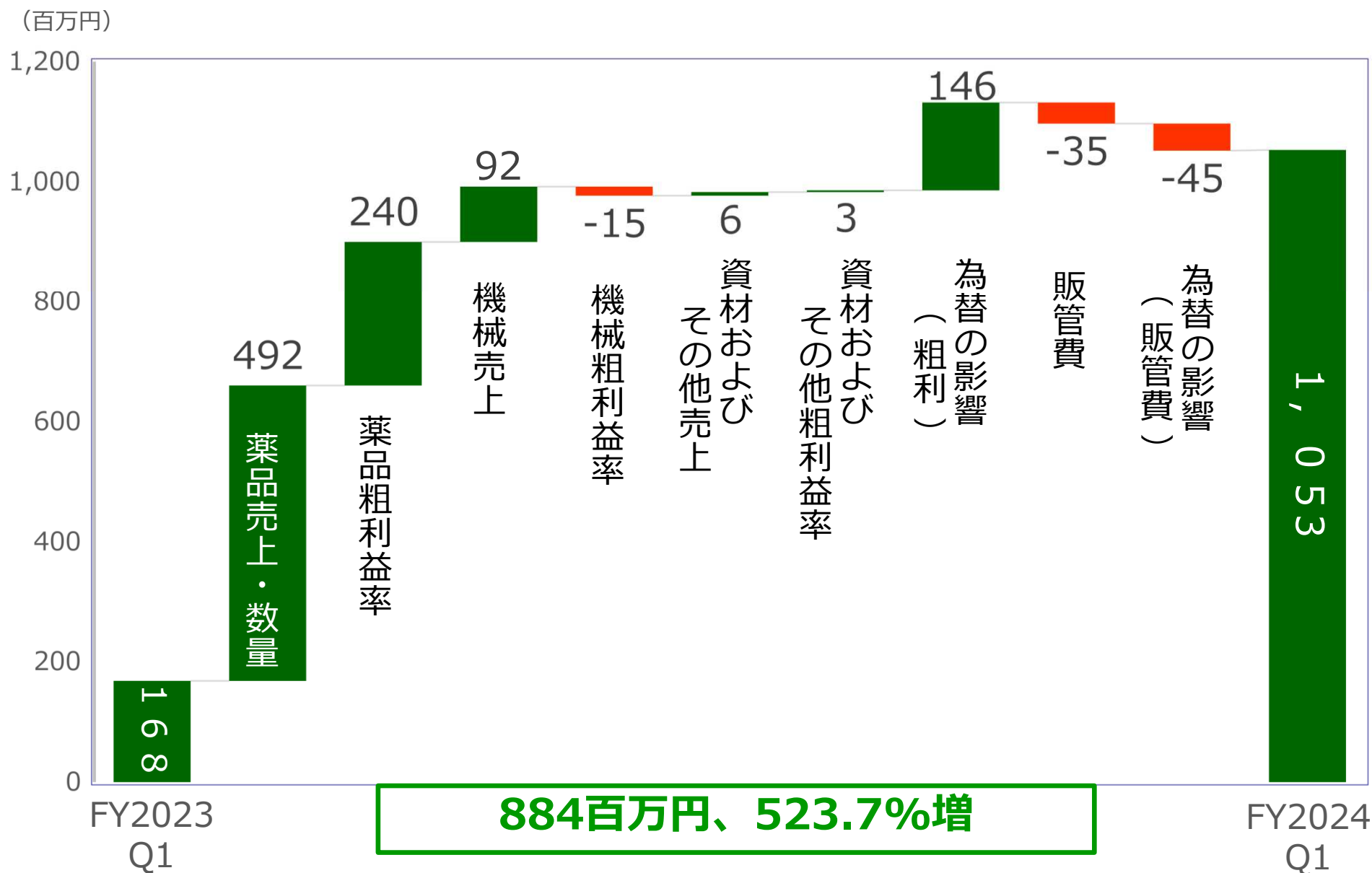
(単位：百万円)

	第1四半期						通期		
	FY23.12 Q1		FY24.12 Q1				FY23.12	FY24.12	
	(実績)	進捗率	(実績)	進捗率	前年同期比	(実績)	(予想)	前期比	
売上高	2,765	19.7%	4,354	25.6%	1,589	57.5%	14,020	17,000	21.3%
薬品売上高	2,712	-	3,924	-	1,211	44.7%	13,764	-	-
売上総利益	1,583	-	2,549	-	965	61.0%	8,316	-	-
売上総利益率	57.3%	-	58.5%	-	-	-	59.3%	-	-
販売費及び一般管理費	1,414	-	1,496	-	81	5.7%	5,824	-	-
売上高比率	51.2%	-	34.4%	-	-	-	41.5%	-	-
営業利益	168	6.8%	1,053	28.9%	884	523.7%	2,492	3,650	46.4%
営業利益率	6.1%	-	24.2%	-	-	-	17.8%	-	-
経常利益	223	8.3%	1,132	29.8%	909	406.4%	2,683	3,800	41.6%
経常利益率	8.1%	-	26.0%	-	-	-	19.1%	-	-
税引前当期利益	219	-	1,128	-	908	414.8%	3,219	-	-
当期純利益	82	3.6%	779	29.4%	697	848.2%	2,304	2,650	15.0%
EBITDA	403	-	1,320	-	917	327.5%	3,993	-	-
1株当たり当期利益 (円)	4.32	-	41.62	-	-	-	122.29	141.52	-
1株当たり配当金 (円)	-	-	-	-	-	-	45.00	45.00	-
ROE	0.4%	-	3.1%	-	-	-	9.6%	10.9%	-

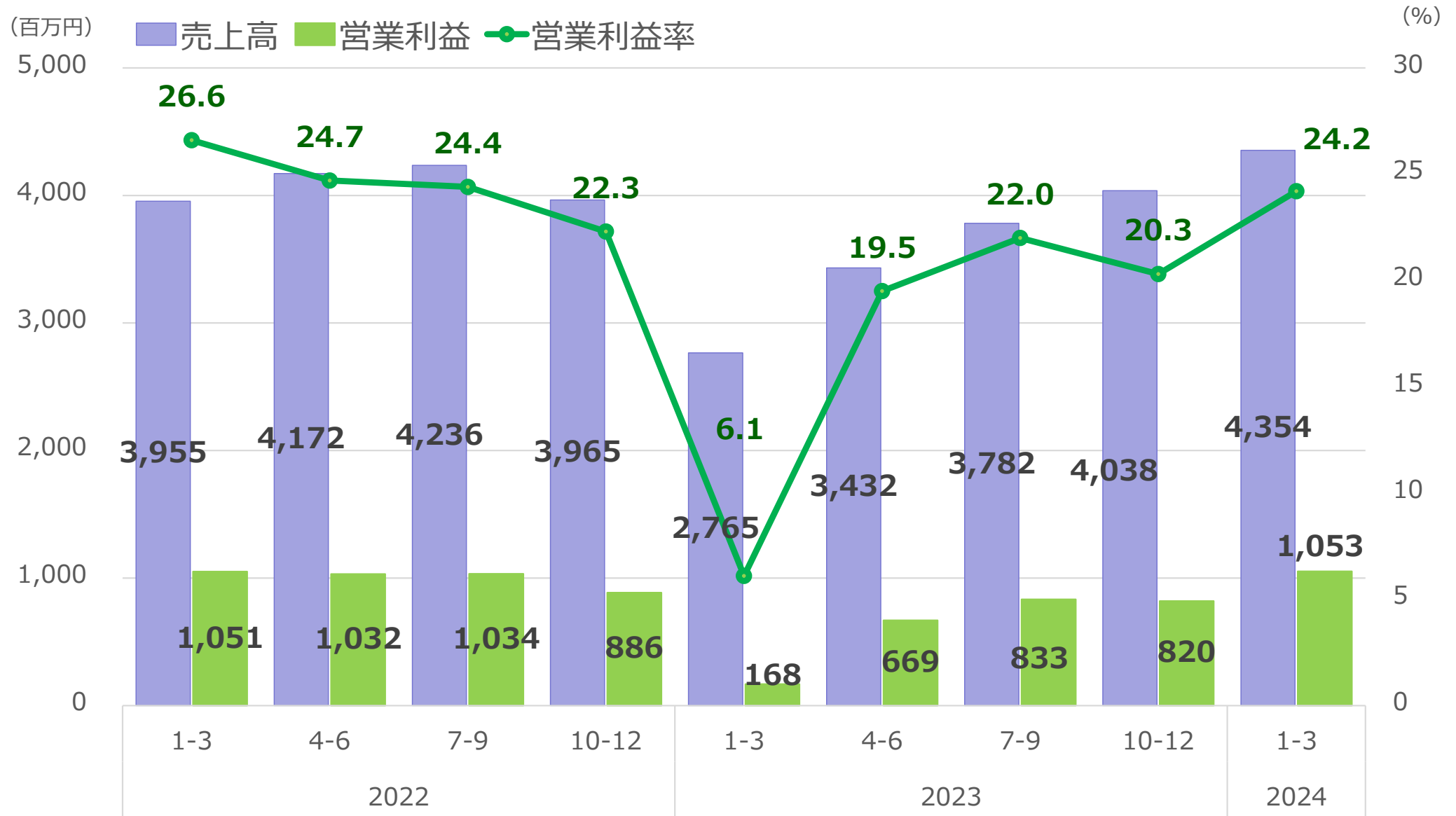
連結売上高前年同期比分析



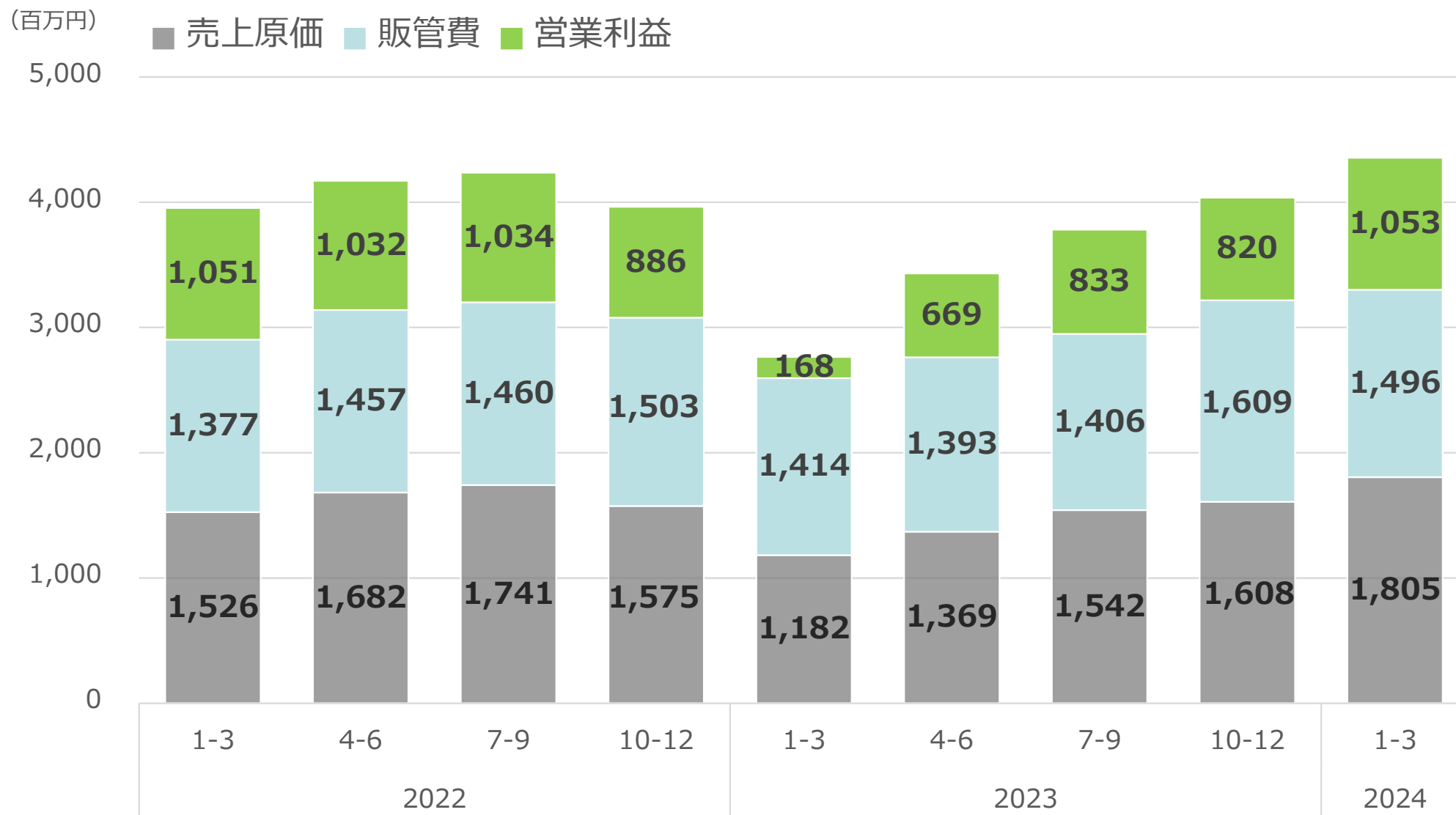
連結営業利益前年同期比分析



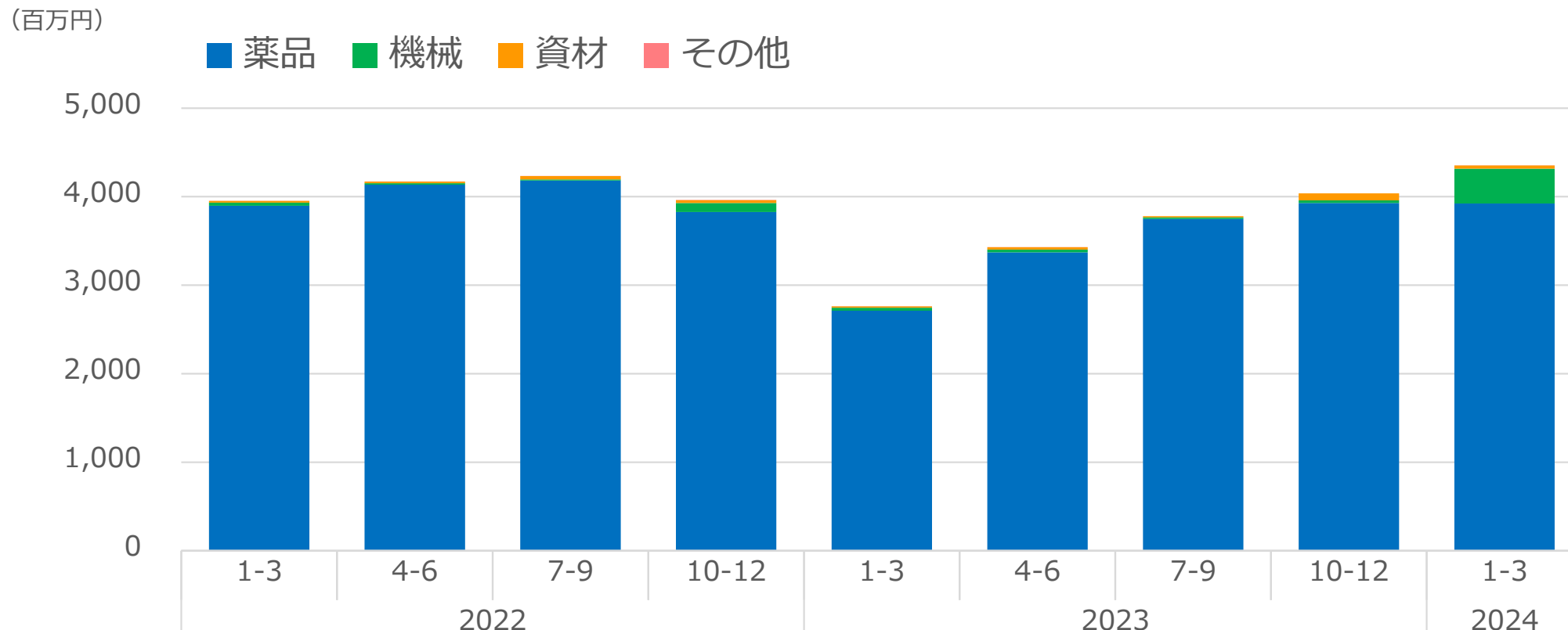
連結売上高と営業利益/営業利益率



連結損益構造

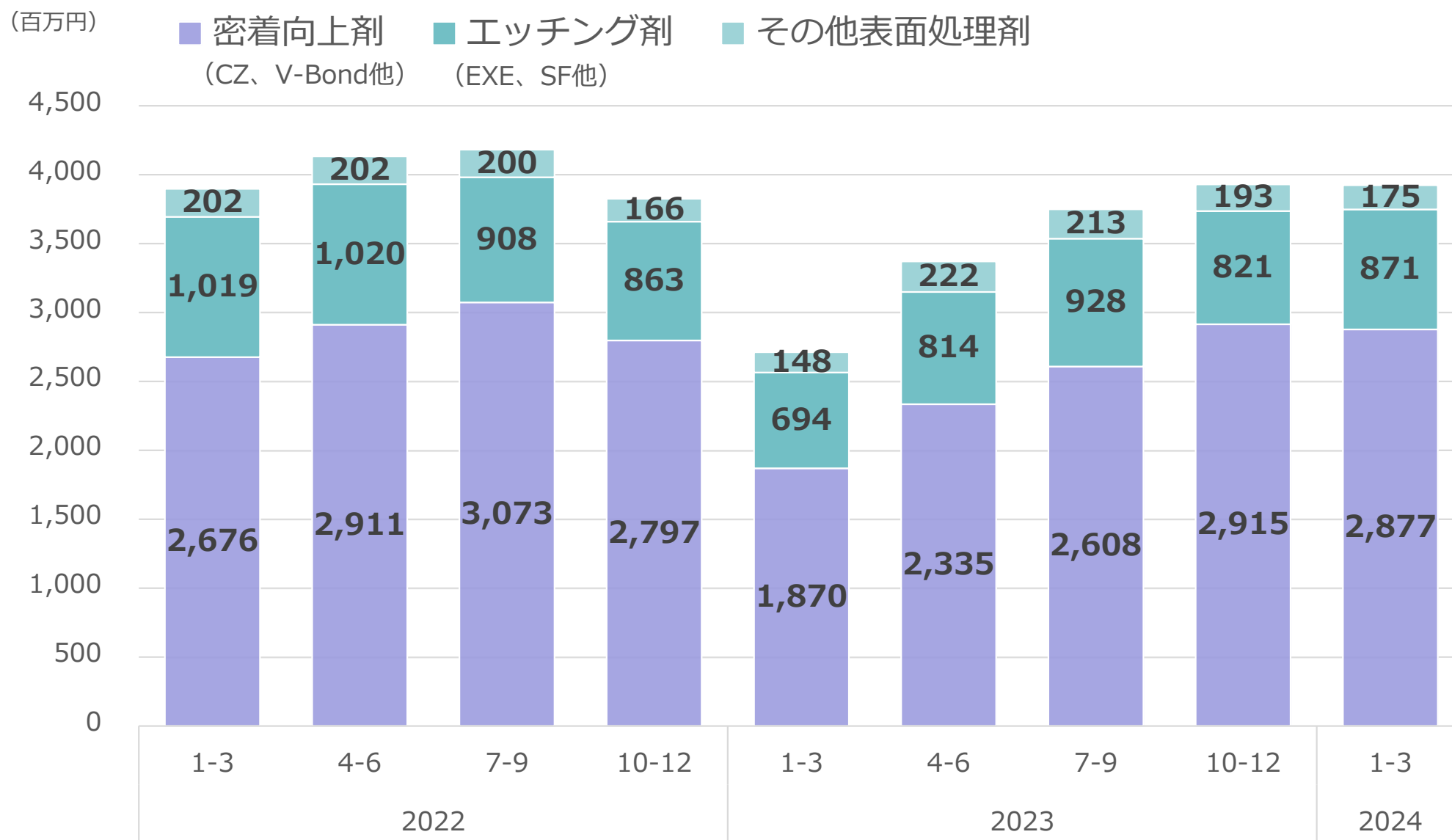


連結品種別売上高

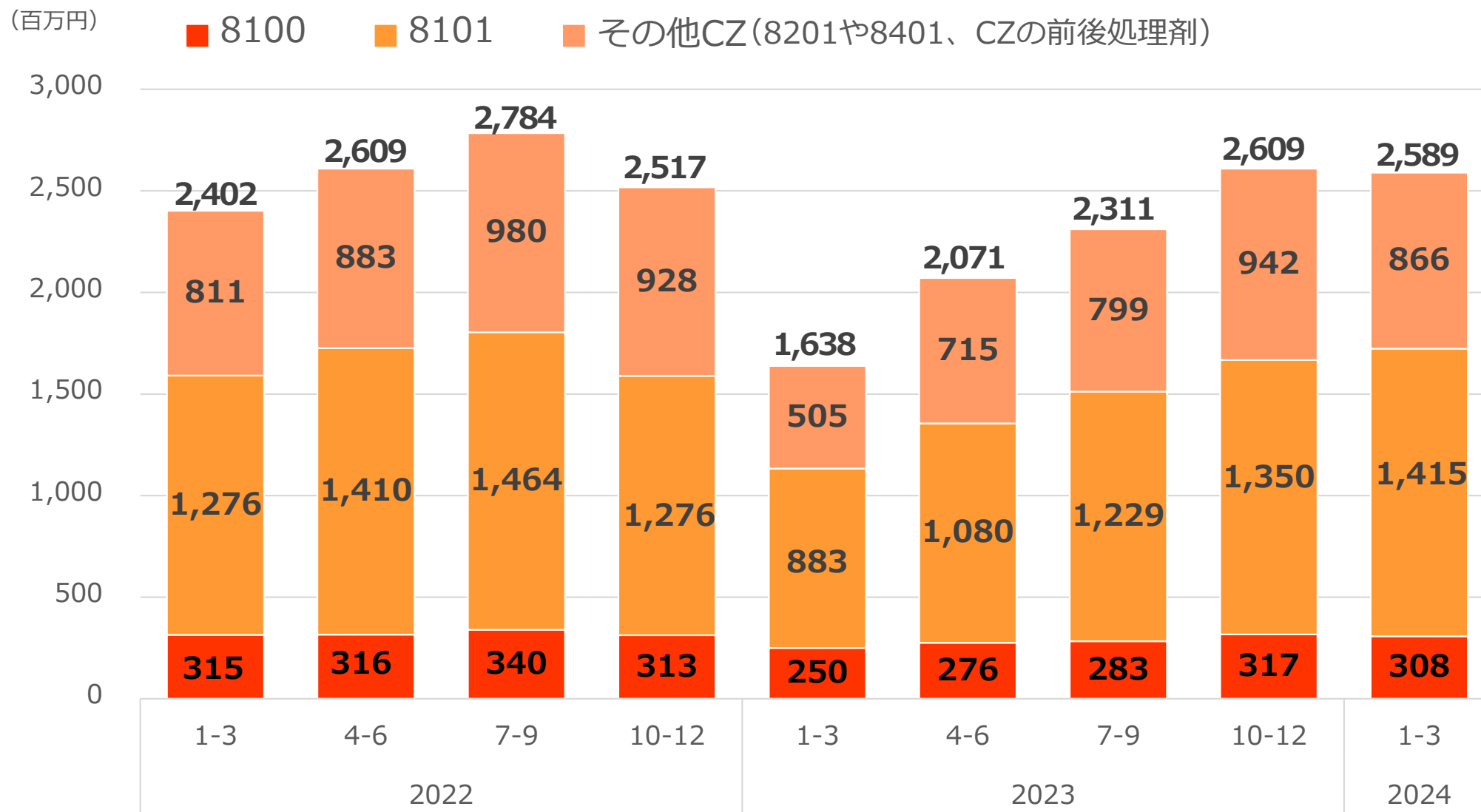


■ その他	1	1	1	3	1	1	0	0	1
■ 資材	18	19	38	31	16	27	15	80	37
■ 機械	36	17	13	102	34	31	17	28	391
■ 薬品	3,898	4,134	4,181	3,827	2,712	3,372	3,749	3,929	3,924

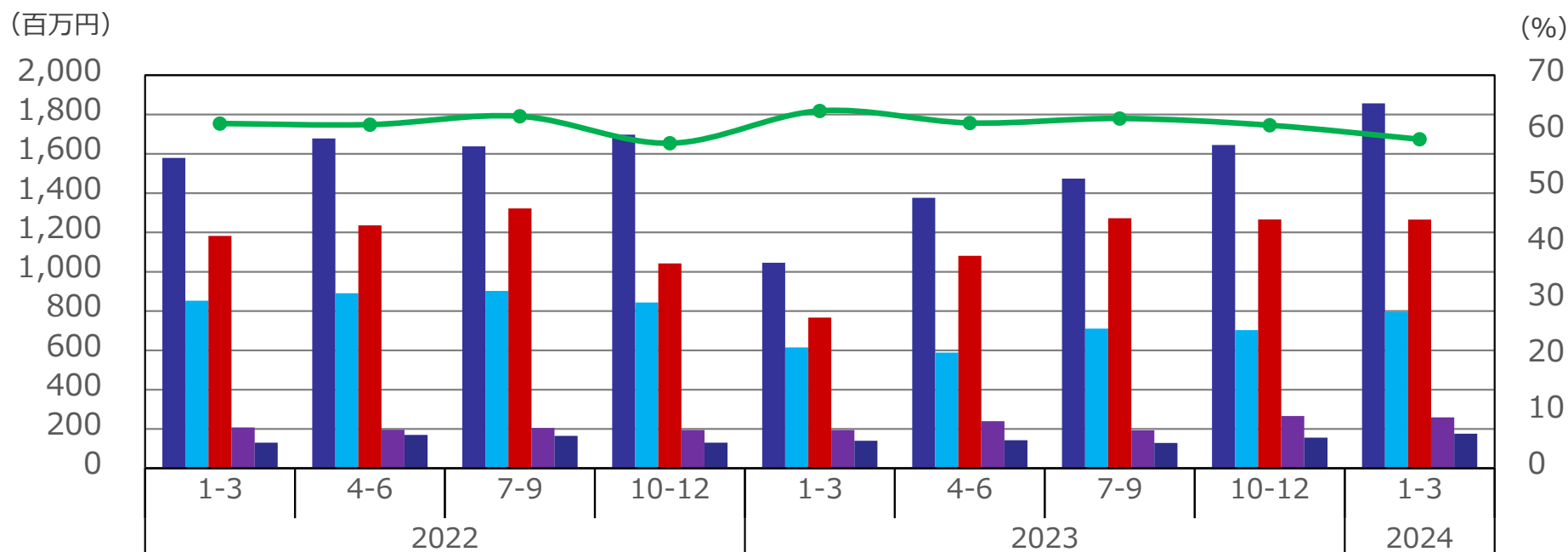
連結薬品別売上高



CZシリーズ売上高



地域セグメント別売上高

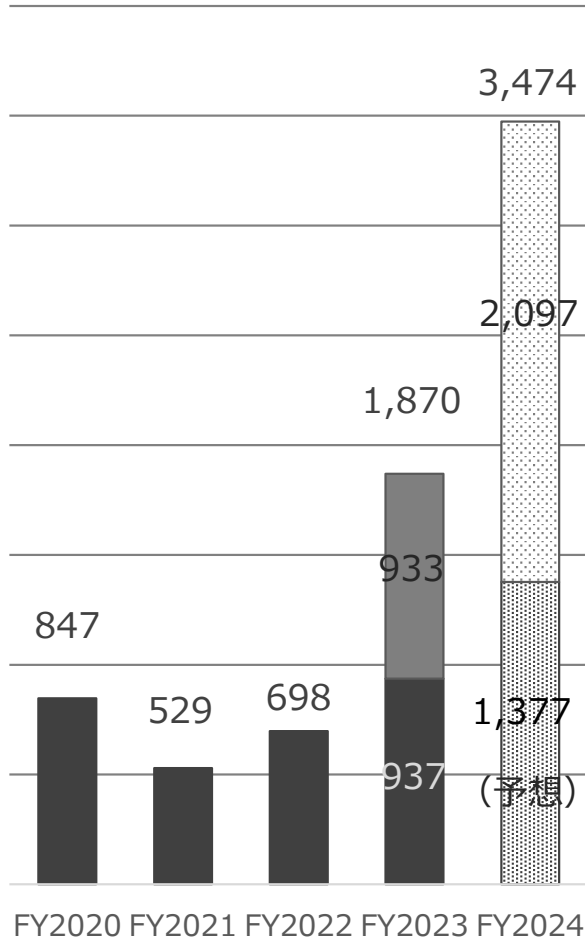


■ 日本	1,579	1,678	1,638	1,698	1,046	1,376	1,474	1,645	1,857
■ 台湾	853	891	903	844	615	589	711	703	795
■ 中国	1,182	1,236	1,322	1,043	767	1,081	1,272	1,266	1,265
■ 欧州	208	196	205	195	195	240	193	266	259
■ タイ	130	170	165	130	140	143	129	156	176
● 海外売上高比率	61.4	61.2	62.7	57.9	63.7	61.5	62.3	61.1	58.6

- ・ 当社薬品海外使用分の国内代理店販売を海外売上高に加算した場合の比率は73.1% (前年同一期間は72.5%)。

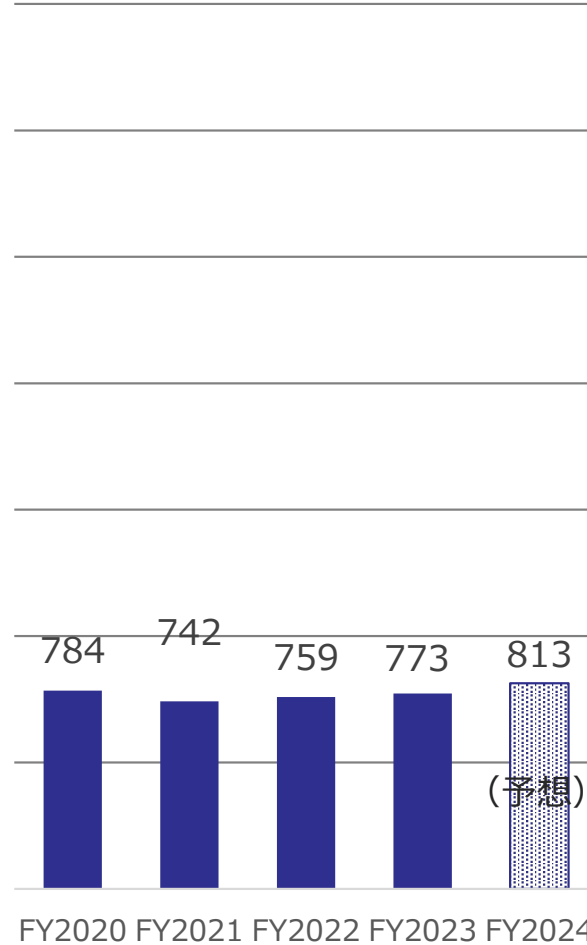
設備投資額と減価償却費、研究開発費

設備投資額 (百万円)



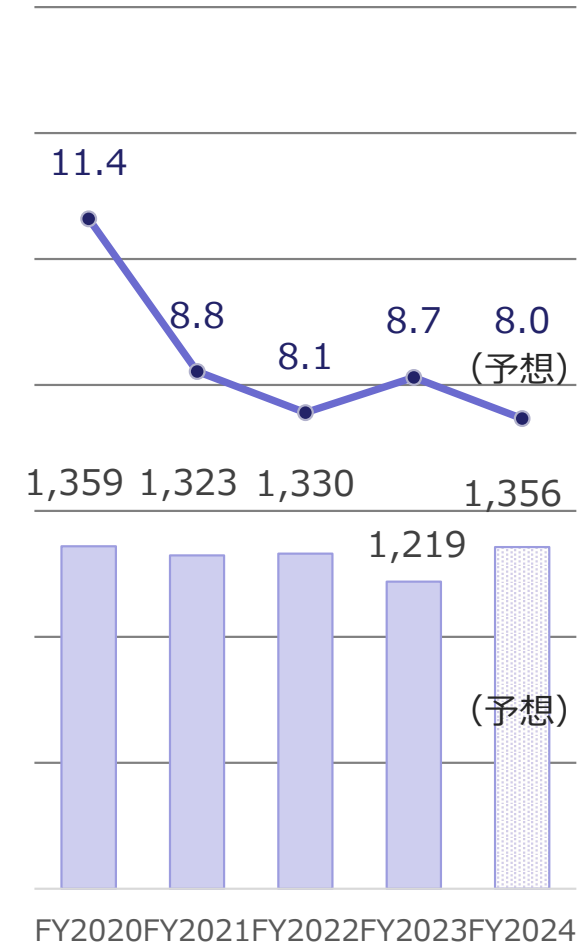
北九州工場に係る設備投資額
 ■ FY2023 933百万円
 ▨ FY2024 2,097百万円 (予想)

減価償却費 (百万円)

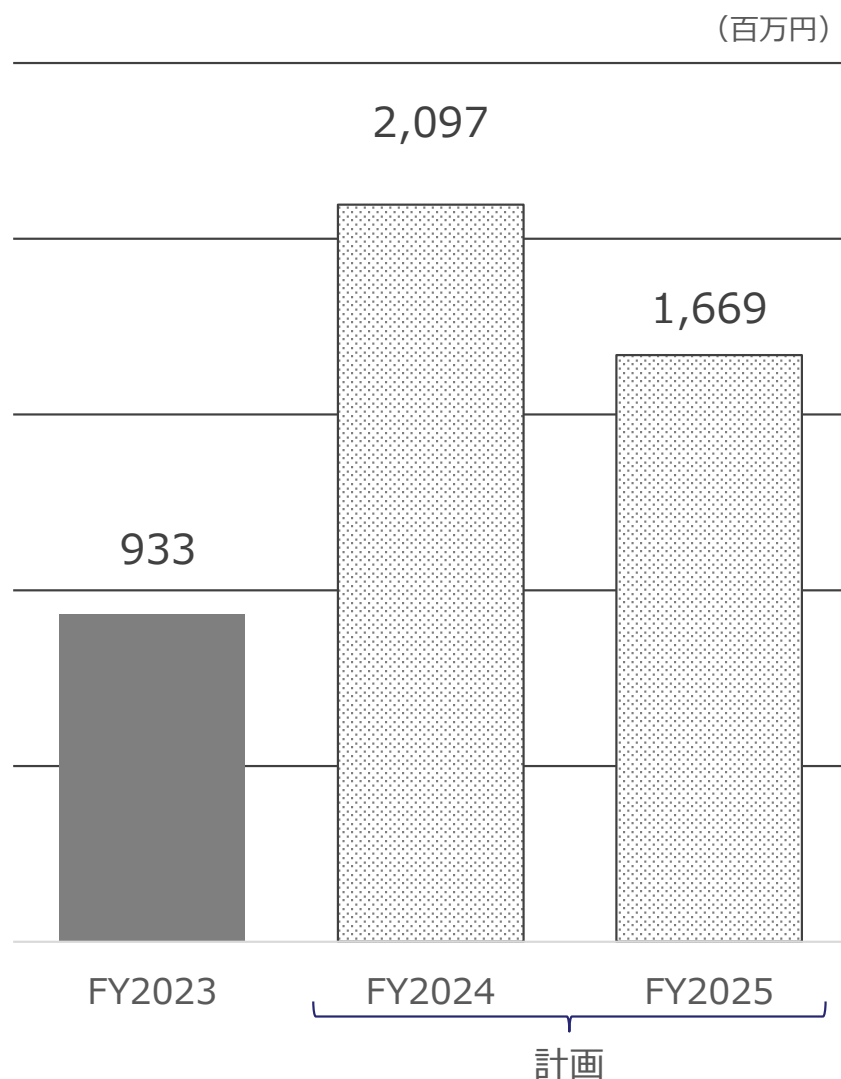


北九州工場に係る減価償却費は稼働後、2~2.5億円/年程度となる見込み

研究開発費と (百万円)
売上高研究開発費比率 (%)



北九州工場（仮称）設備投資計画



北九州工場設備投資計画に係る減価償却費は稼働後、2～2.5億円/年程度となる見込み

北九州工場（仮称）



- ✓ 福岡県北九州市若松区
- ✓ 敷地面積 29,889m²
- ✓ 生産能力 約30,000t/年（予定）
- ✓ 総投資額 約47億円（土地取得費含む）
- ✓ 着工 2024年8月（予定）
- ✓ 稼働 2025年10月（予定）

当社の技術と今後の見通し

主要薬品用途と最終製品例

主要薬品	特徴	最終製品例
超粗化系密着向上剤 「CZシリーズ」	銅と樹脂との密着性を高める銅表面処理剤。 主にPKG基板向けの密着向上剤で、高密度PCBにも使用される。	5G/6G関連・データセンター等のインフラ、パソコン・スマートフォン・タブレットPC等の高機能デバイス等
多層電子基板向け密着向上剤 「V-Bondシリーズ」	銅と樹脂との密着性を高める銅表面処理剤。 多層基板向けの密着向上剤で、PKG基板には使用されない。	スマートフォン・クルマ等
異方性エッチング 「EXEシリーズ」	サブトラで微細配線形成ができる。 主にCOF基板向けのエッチング剤として使用される。	テレビ・パソコンのモニター等
選択エッチング銅除去剤 「SFシリーズ」	銅への選択性を持ったエッチング剤。	タブレットPC等

④ 事業環境

- ・短期的には、回復局面にある半導体市況や個人消費の影響を見込む。
- ・中長期的には、デジタル革命の進展に伴い技術革新が進み、IoTやAI、5G/6G、クルマの電動化・自動化・コネクテッド化やDX・GXの進展等、技術の広がりを背景に技術革新が進み、当社関連市場の拡大が進む。
- ・特に高まる半導体需要によるPKG基板の増加、超高密度化や超高周波化により関連する「CZシリーズ」、「化学密着向上剤」需要の伸びを見込む。

④ 主要製品

- CZ : 短期的には半導体市況回復の影響を受ける。
中長期的にはPKG基板の増加、大型・高多層化等により需要拡大。
- V-Bond : 短期的にはクルマ、スマートフォンは回復基調。
- EXE : 短期的にはディスプレイの在庫調整が進み回復基調。
継続性は不透明。
- SF : スマートフォン向けは技術変化により減少。
タブレットPC向け需要は継続。

PKG基板の超高密度化、超高周波化

超高密度
超高周波

最先端品 化学密着向上剤 APシリーズ

L/S=3/3 μ m

Flat Organic Adhesion Promotor

先端品

CZ-8401
×化学密着向上剤 APシリーズ

L/S=3/3 μ m

Super finely roughen + Organic Adhesion Promotor

CZ-8201

L/S=15/15 μ m

Very finely roughened

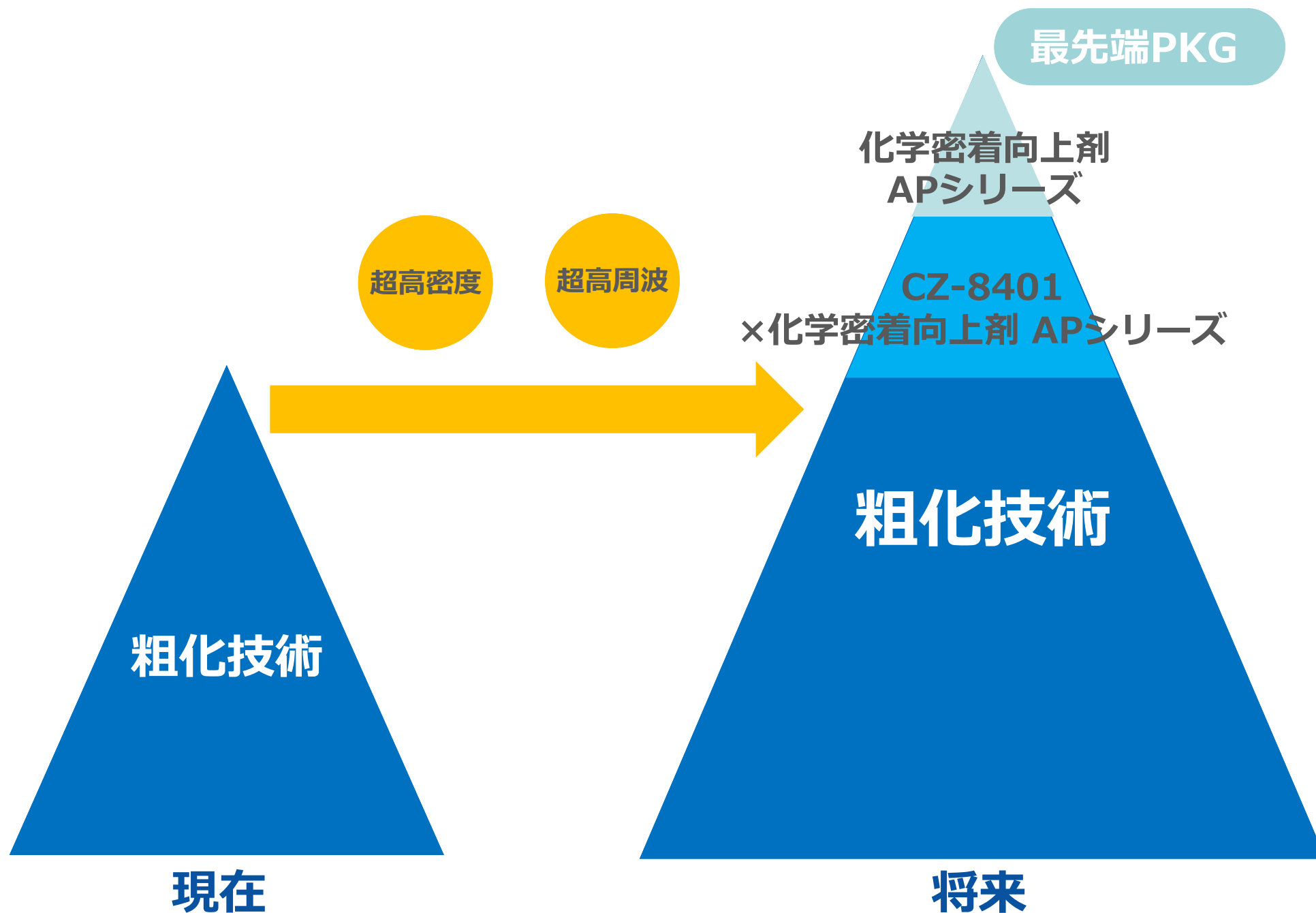
汎用品

CZ-8101

CZ-8100

L/S=15/15 μ m

Finely roughened



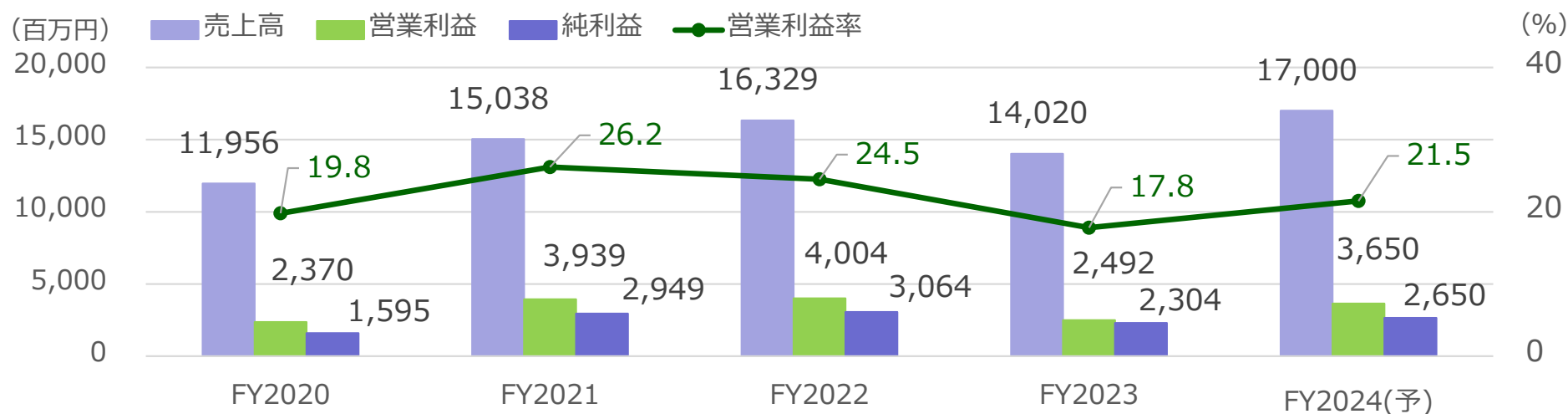
新拠点について



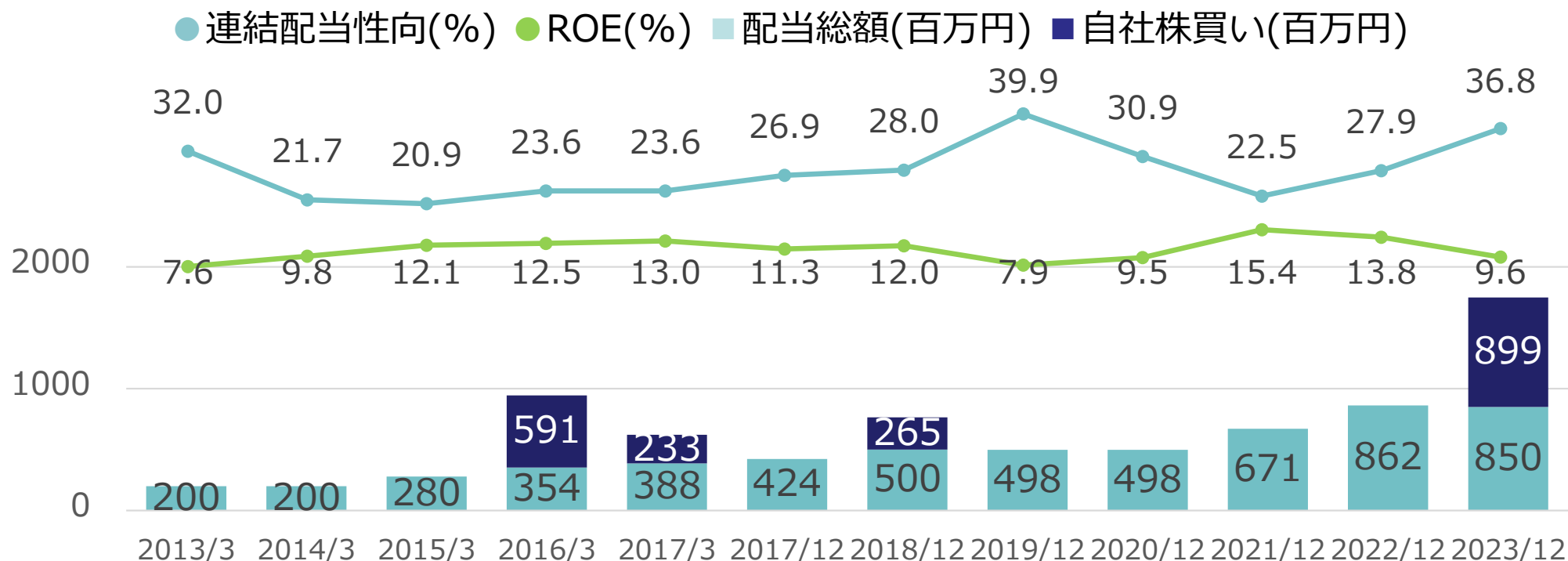
所在地	福岡県北九州市若松区向洋町 10 番
敷地面積	29,889 m ²
着工時期	2024 年 8 月 (予定)
総投資額	約 47 億円 (土地取得費含む)
投資計画	自己資金および負債調達による充当 (予定)
生産能力	約 30,000t/年 (予定)
新規雇用従業員数	10~20 名 (予定)
稼働開始時期	2025 年 10 月 (予定)

2024年12月期 連結業績予想

	FY2023		FY2024 (2024/5/10修正)					
	百万円	利益率 (%)	1H			Full-year		
			百万円	利益率 (%)	増減率	百万円	利益率 (%)	増減率
売上高	14,020	-	8,350	-	34.7%	17,000	-	21.3%
営業利益	2,492	17.8	1,800	21.6	114.7%	3,650	21.5	46.4%
経常利益	2,683	19.1	1,900	22.8	89.4%	3,800	22.4	41.6%
純利益	2,304	16.4	1,300	15.6	20.8%	2,650	15.6	15.0%
1株当たり純利益 (円)	122.29	-	69.43	-	-	141.52	-	-



配当金総額と連結配当性向、ROEの推移



+ 配当性向

中期目標 連結配当性向 30%

+ ROE

2024年目標 10%以上

+ 2024年12月期 配当予想

45.0円 (中間 20.0円、期末 25.0円、連結配当性向31.8%)

* 2023年12月期実績 : 45円 (中間20.0円、期末25.0円)

Environment

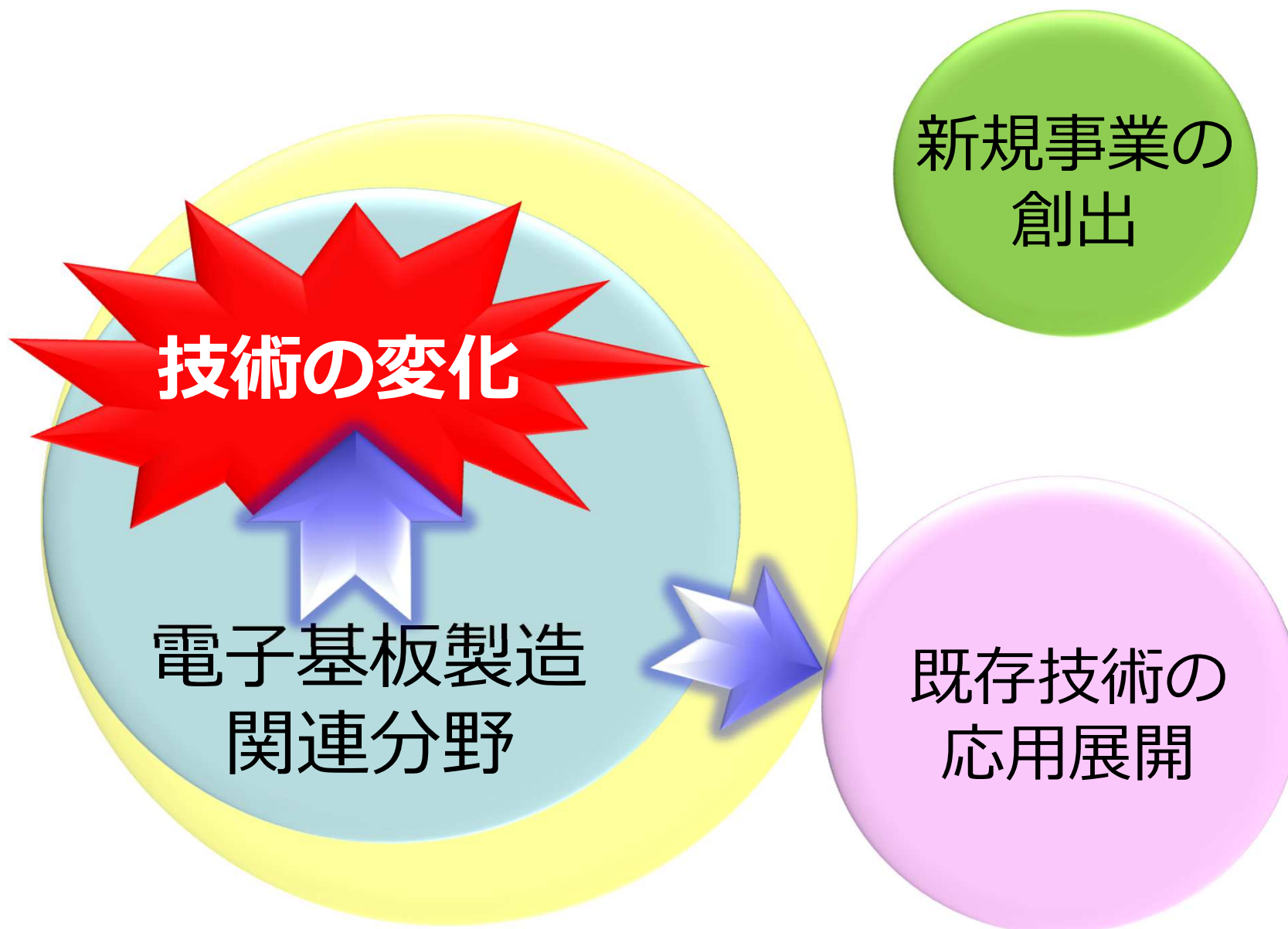
- 環境負荷低減製品の開発
- 適正な化学物質管理
- 気候変動問題への対応

Social

- 人的資本戦略
- 多様な人財の活用（女性活躍、WLB、男性の育休取得推進等）
- 産業発展への貢献（高速通信整備、自動運転、AI、DX、GX等）

Governance

- 経営基盤の強化（CG体制、各種委員会、リスクマネジメント等）

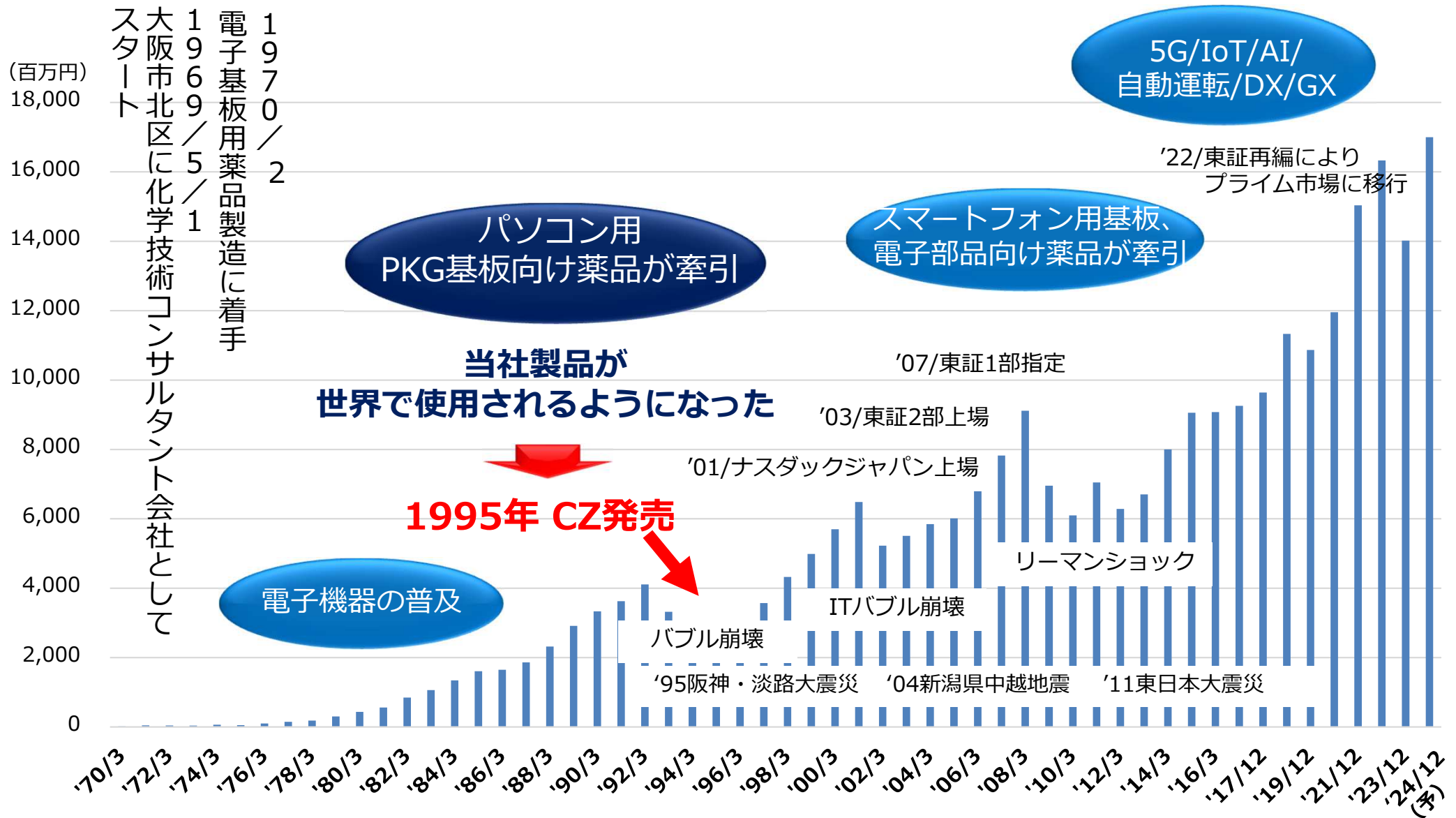


參考資料

(2023年12月31日現在)

社名	メック株式会社 MEC COMPANY LTD.
本社所在地	兵庫県尼崎市杭瀬南新町3丁目4番1号
設立年月日	1969（昭和44）年5月1日
主な業務内容	電子基板・部品製造用薬品の開発・製造販売 及び 機械装置、各種資材の販売
代表者	代表取締役社長 前田 和夫
資本金	5億9,414万2,400円
連結売上高	140億20百万円
上場市場	東証プライム市場（4971／化学セクター）
従業員数	連結454名、単体263名

創業からの売上推移





研究所から
工場へ

テーマ決定 ⇒ ビーカー実験 ⇒ スケールアップ実験 ⇒ 応用ライン検証



お客様へ



製造 ⇒ 品質検査 ⇒ 充填

当社製品の使用工程例

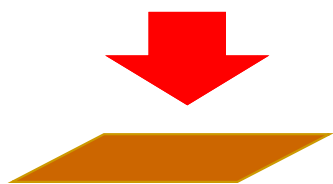
≪乾燥処理≫



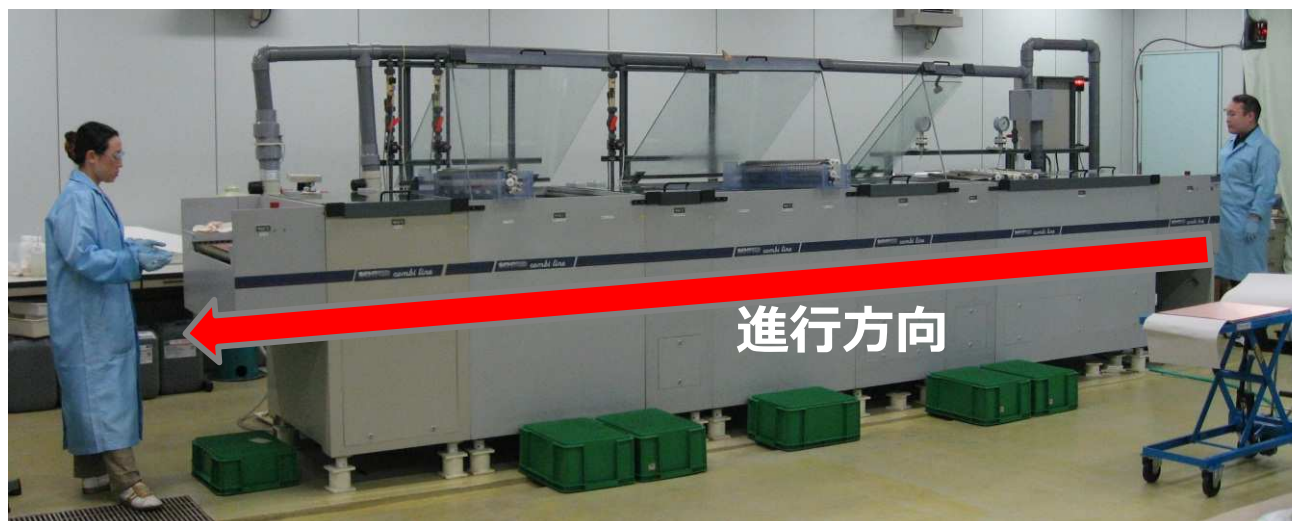
≪水洗処理≫



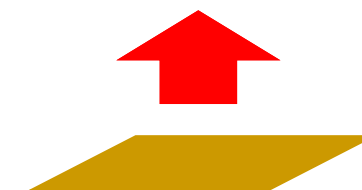
≪薬液処理≫



基板受取



進行方向

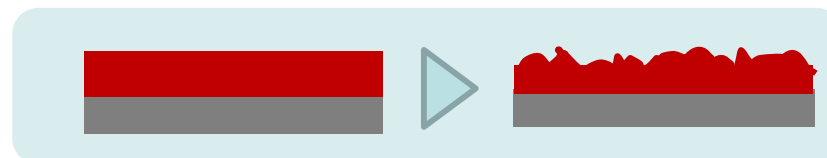


基板投入

界面価値創造

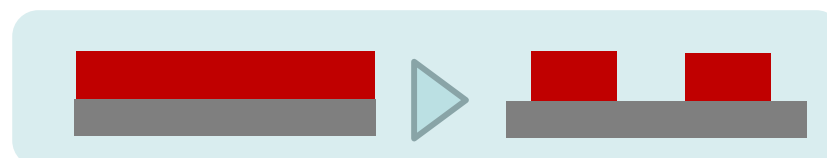
- **表面を粗化し、機械的に密着性を向上**

CZ、V-Bond



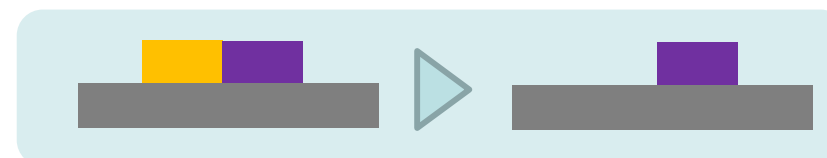
- **配線を形成する**

EXE

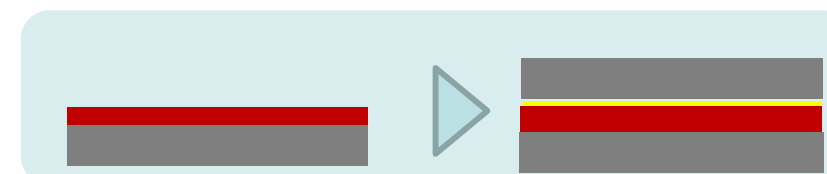


- **選択エッチング**

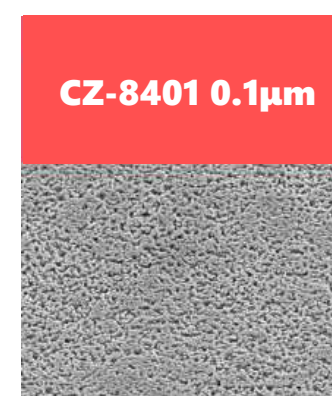
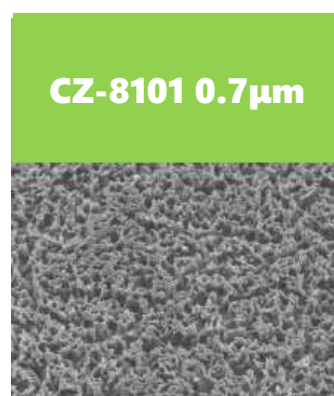
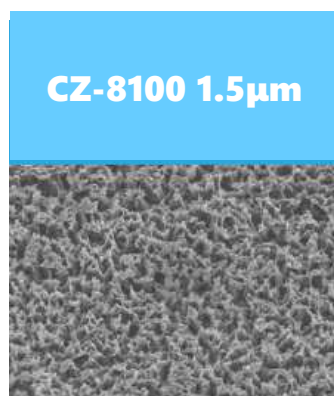
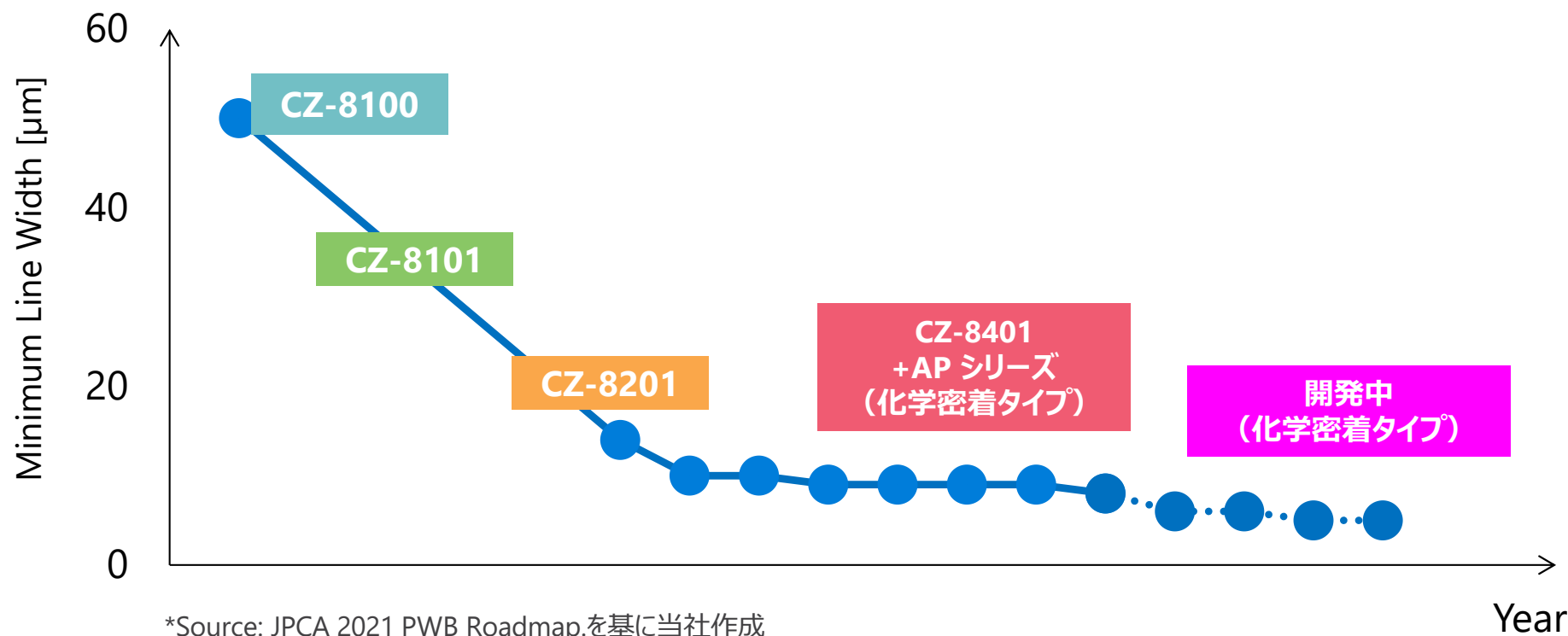
SF



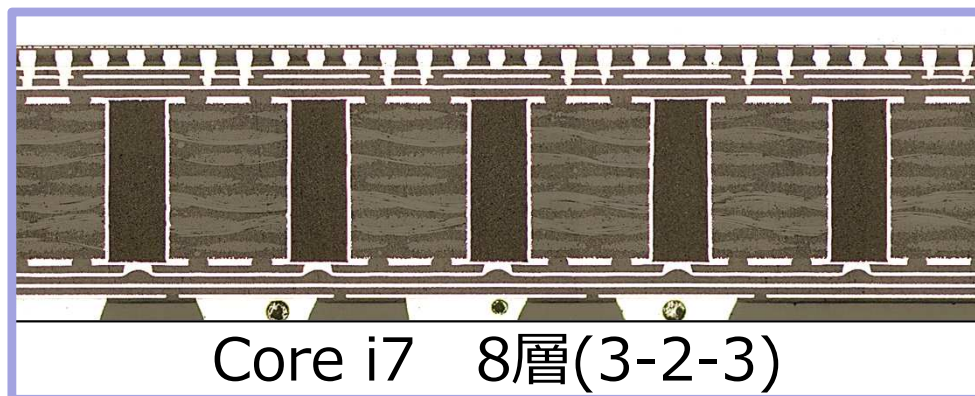
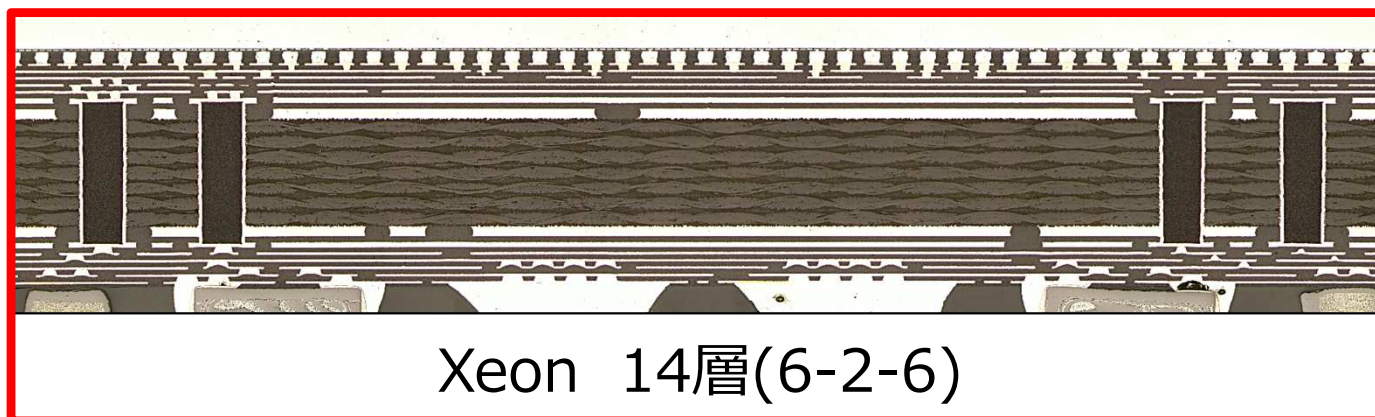
- **表面を処理し、化学的に密着性を向上**



CZシリーズのロードマップ



PKG基板の断面

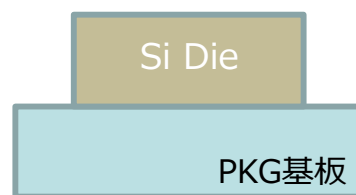


	PKG面積	層数
Xeon	27.44 cm ²	14
Core i7	14.44 cm ²	8
Ryzen	16.00 cm ²	12

*当社で入手、分解しました

通常のPKG

一つのPKGに
一つの半導体



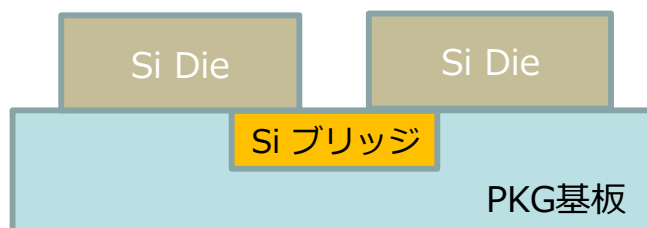
Chiplet

PKGを大きくし
複数の半導体を搭載



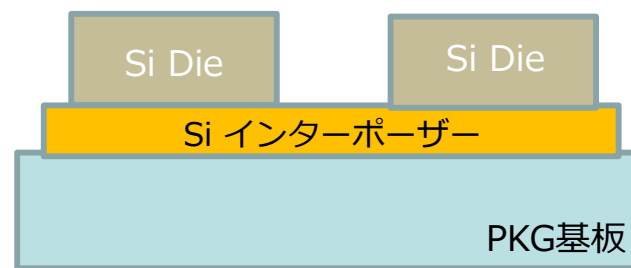
EMIB

(Embedded Multi-die Interconnect Bridge)



CoWoS

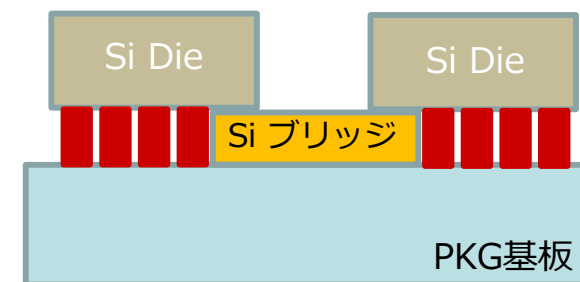
(Chip on Wafer on Substrate)



EFB

■ 銅ピラー

(Elevated Fanout Bridge)



PKG基板 ⇒ サイズ大型化、層数増加



尼崎工場（少量多品種）
900 t /月



長岡工場（量産工場）
2,750 t /月



メック台湾
1,200 t /月



メック中国（蘇州）
450 t /月



メック珠海
1,000 t /月



メックヨーロッパ
400 t /月



メックタイ
500 t /月

2023年12月現在

界面価値創造

Creating and Fostering Value at Various Interfaces

このプレゼンテーション資料には、2024年5月10日現在の将来に関する予測が含まれております。記述している将来予測および業績予測は、当社が現時点で入手できる情報に基づき判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、様々な要因の変化により実際の業績は記述している将来見通しとは大きく異なる結果となる可能性があることをご承知ください。

